

股票代碼：3580

# 友威科技 營運簡報

Date：113/12/13

投資人關係聯絡方式：

E-mail：[theresachen@uvat.com](mailto:theresachen@uvat.com)

**UVAT**  
Vacuum Ecosystems

# 會議流程

01

公司沿革

02

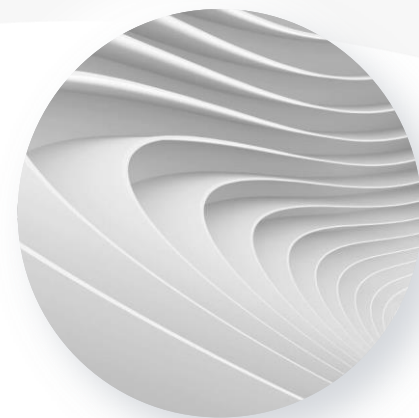
技術分享與產品

03

經營實績

04

未來展望

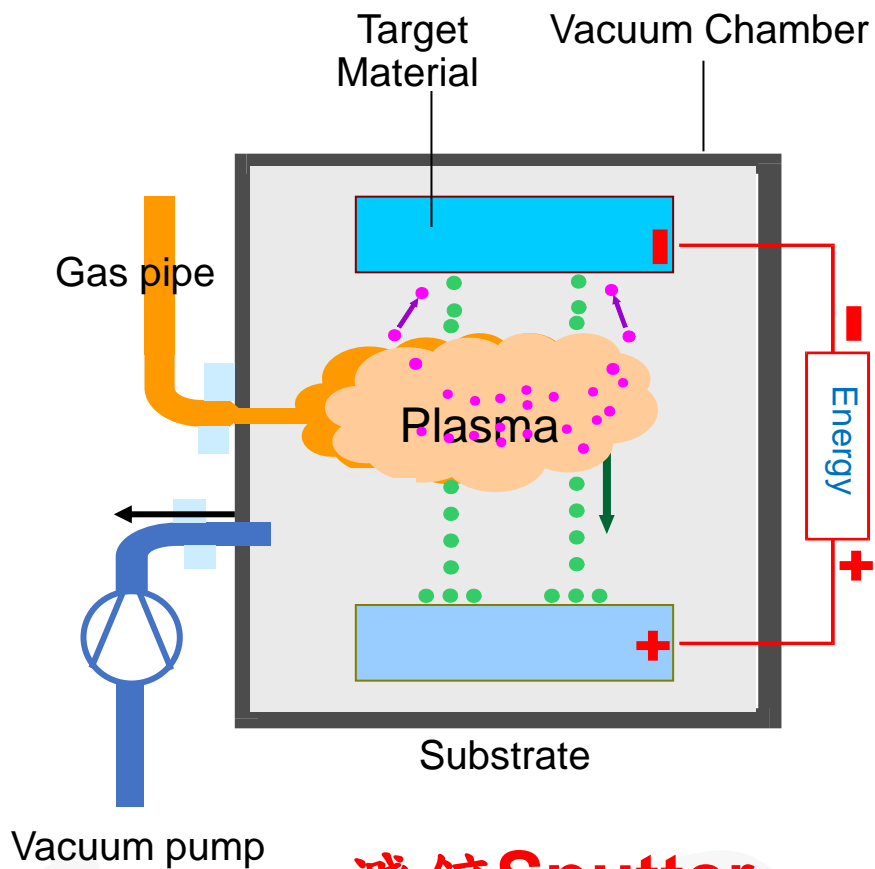




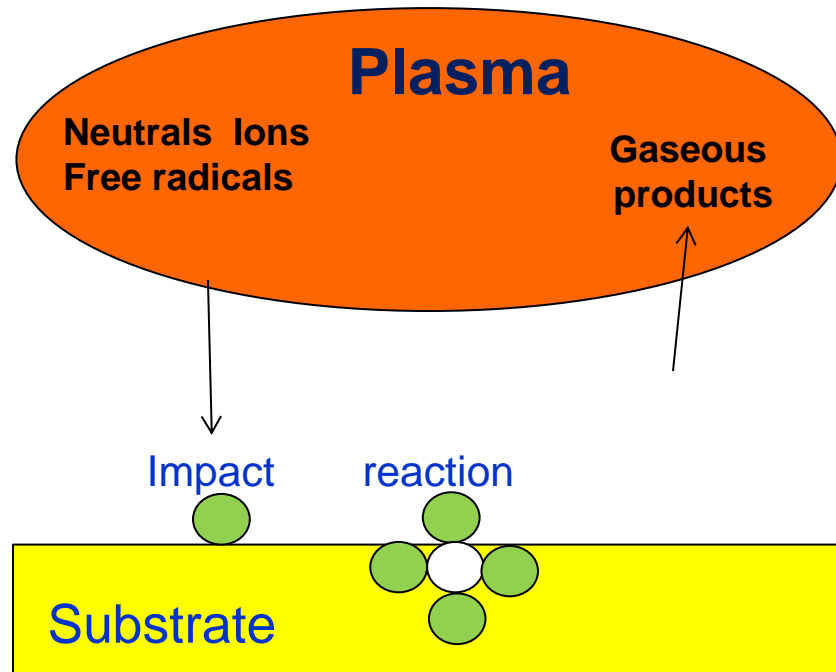
01

公司沿革

# 乾式(Dry)製程的解決方案



濺鍍 Sputter



電漿蝕刻 Plasma Etch

# 友威的核心

乾式Dry  
真空製程

濺鍍  
Sputtering

蝕刻  
Etching

ESG  
綠色製程  
環保製程

薄型化  
薄膜化

# 關於友威

成立時間	2002/11/04
董事長	李原吉
資本額	新台幣3億9,470萬
員工	台灣：120人 海外：約150人
服務項目	真空濺鍍設備 蝕刻設備 半導體設備及相關耗材 鍍膜代工 光學鍍膜 薄膜元件



- ❖ 2007年股票公開發行
- ❖ 2008年Forbes亞太200大最佳中小企業
- ❖ 2010年7月9日股票上櫃(友威科3580)

# 營運據點



## ■ 台灣

- 位址：台中
  - 研發中心
  - 設計中心
  - 設備製造
  - 客戶服務
  
- 位址：桃園
  - 濺鍍代工
  - 客戶服務

## ■ 中國

- 位址：深圳/重慶
  - 濺鍍代工
  - 客戶服務

## ■ 馬來西亞

- 位址：麻波Muar
  - 客戶服務
  - 業務拓展

# 里程碑

2002-2010

2010-2015

2015-2020

2020-2025

**UVAT**

2002年11月  
友威科技成立

跨足SDC領域，  
為MOTOROLA、  
NOKIA供應商

富士康  
APPLE i PHONE 3  
濺鍍設備

跨入  
汽車後視鏡產業

**MOTOROLA**  
**NOKIA**  
**FOXCONN**

南亞電路板  
完成四條線建置

臻鼎科技  
薄NPL膜銅濺鍍

景碩科技  
薄膜銅濺鍍

跨入  
被動元件薄膜電容

**Zhen Ding Tech.**  
**KINSUS**

**ACCESS**  
ACCESS  
乾蝕刻設備

系統級封裝EMI

跨入  
汽車輪圈鍍膜

台灣積體電路  
TSMC

SPIL供應商

**ShuSi**  
**TONG HSING**  
同欣電子  
**tsmc**  
**SPIL**

**LIST** 禮鼎科技  
LEADING TECH

晶片內埋技術

金屬奈米銀  
散熱技術

欣興高階載板

扇外型面板級封裝  
(FOPLP)

**Unimicon**  
欣興電子  
**ST**  
life.augmented  
**INNOLUX**  
群創光電

Sputter

Etch

Semi

**UVAT**

# 台灣精品獎

## UVAT

產業類別：生產力&能源精品

產品型號：鈦銅種子層濺鍍機

### 連續式真空濺鍍機



台灣精品 2021  
TAIWAN EXCELLENCE



# 蝕刻 Dry Etch

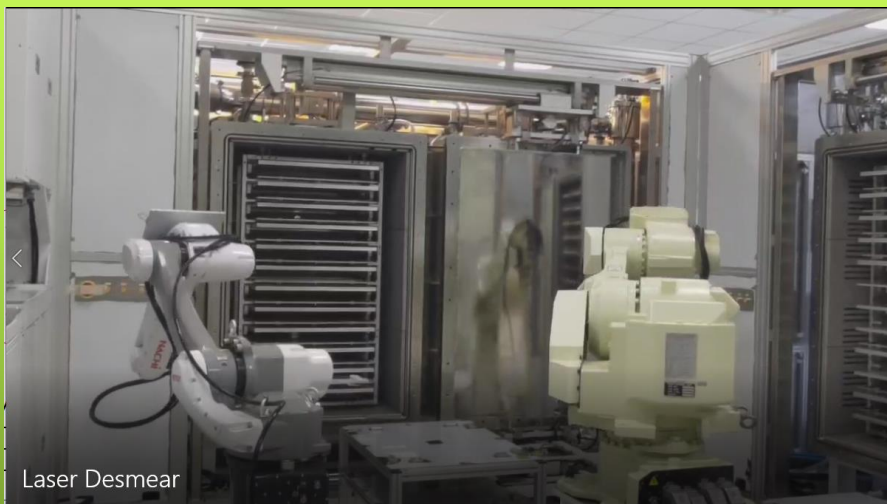


中科管理局-  
2021創新產品獎



經濟部-  
中小企業創新研究獎

- Panel level plasma treatment



- High aspect ratio plasma descum



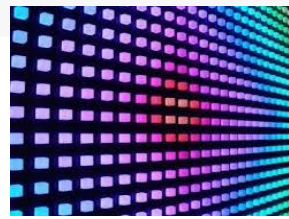
- Fine pitch metal etch



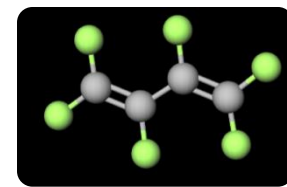
# 產品應用的市場



汽車



石英產業



消費性  
電子

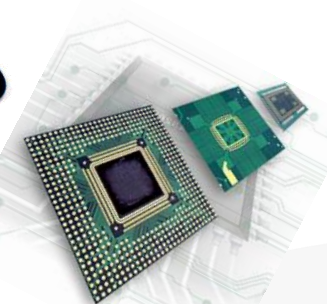
光學  
產業

被動元件

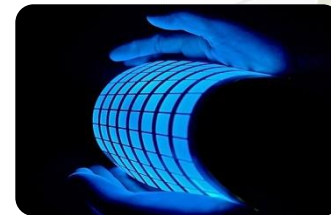


IC 載板  
電路板

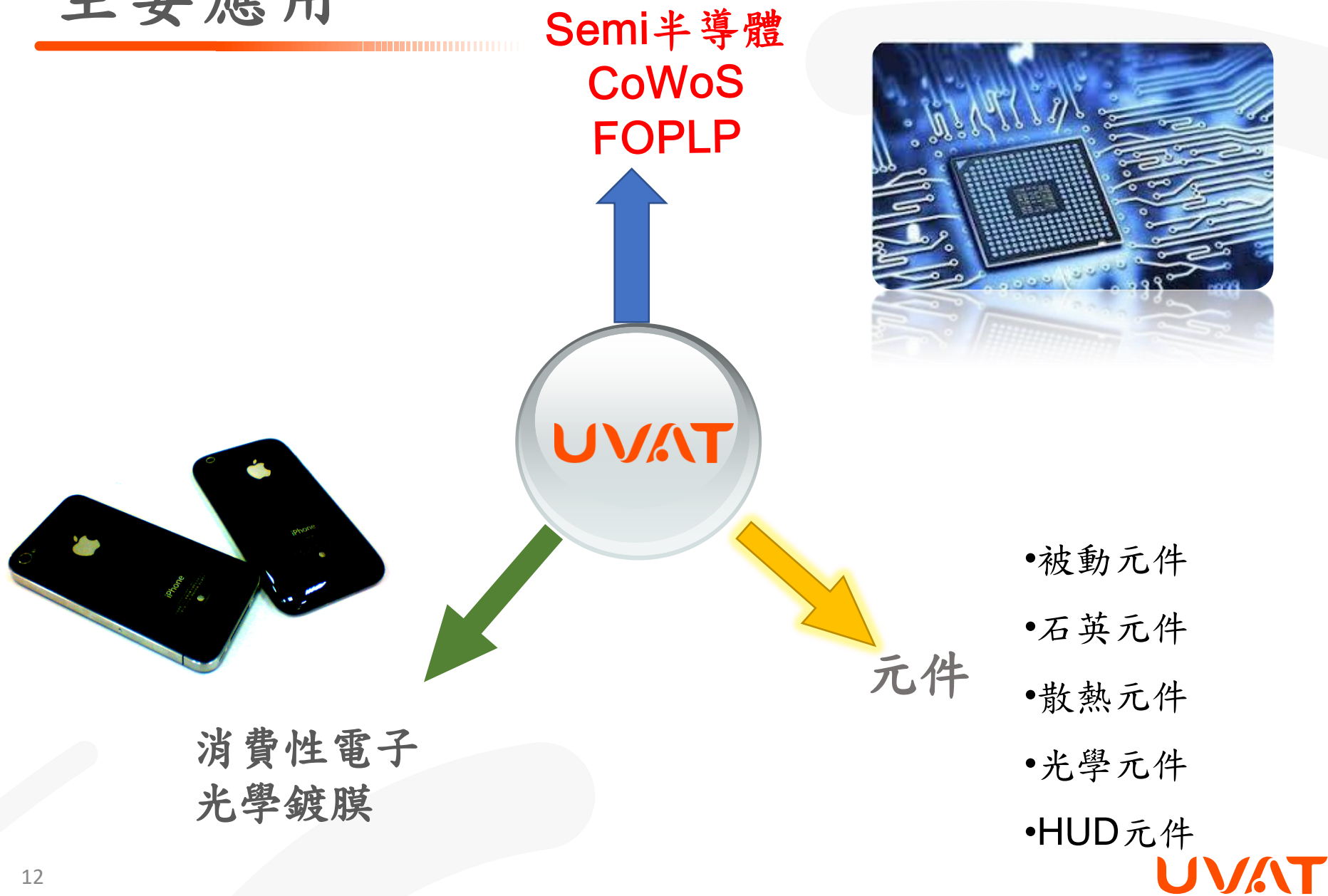
半導體封裝



晶片內埋



# 主要應用





02

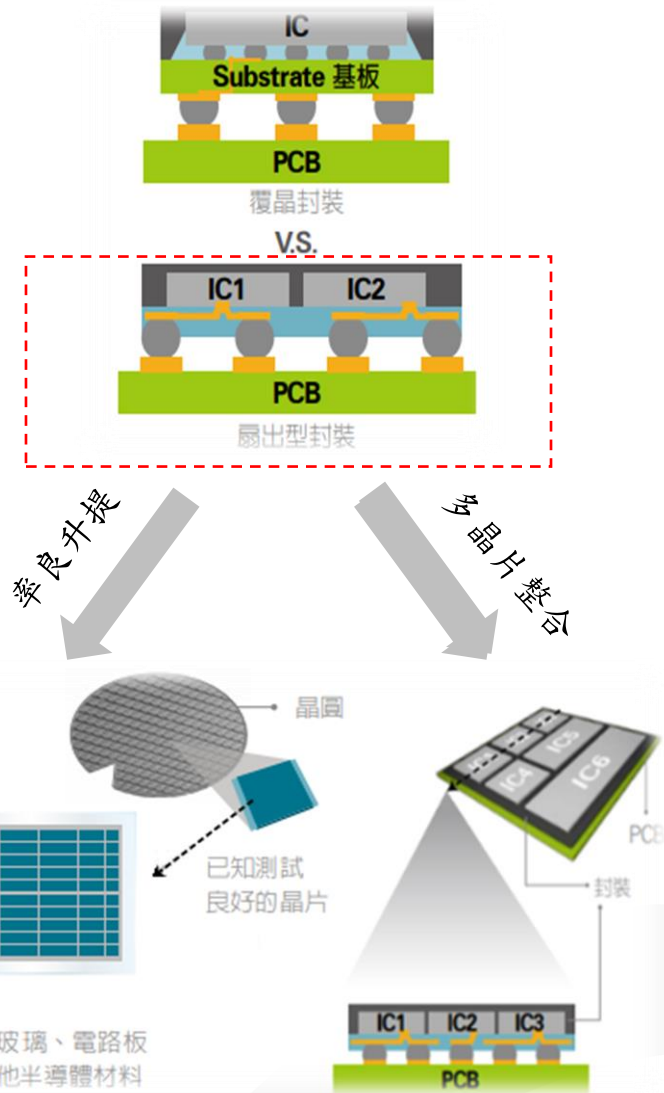
技術分享與產品

# 高階封裝應用\_FOPLP

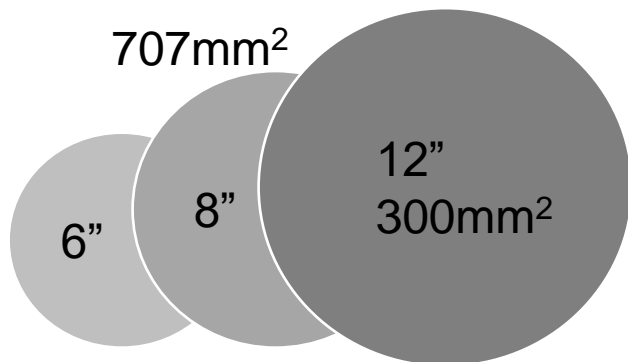
中高階載板供應不足下，驅使無載板、可  
一次性大面積封裝且有效降低製造成本的  
面板級封裝 **FOPLP** 應用備受矚目。

優勢：

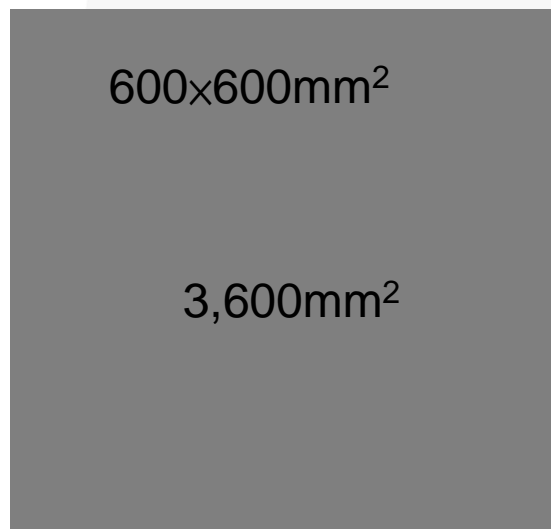
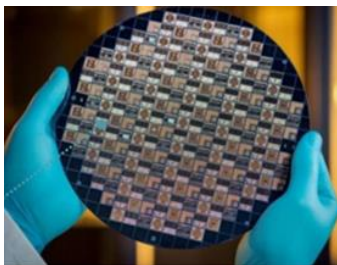
- 挑出良好IC 進行封裝，提升良率
- 多晶片異質晶片整合
- 縮小封裝體積
- 大面積封裝降低成本



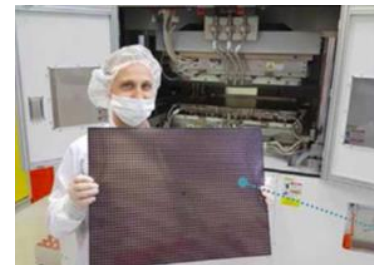
# FOPLP的優勢



晶圓技術 FOWLP



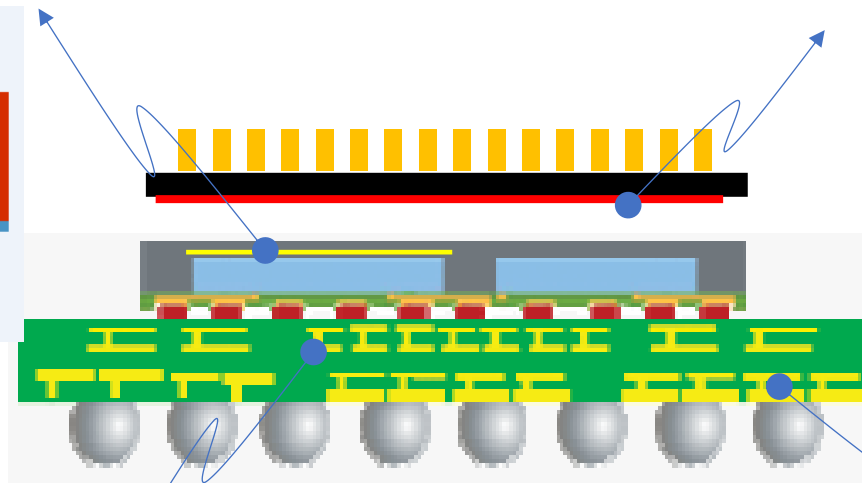
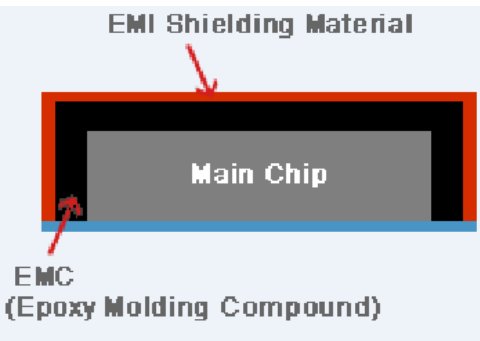
載板/面板技術



# 高階封裝應用

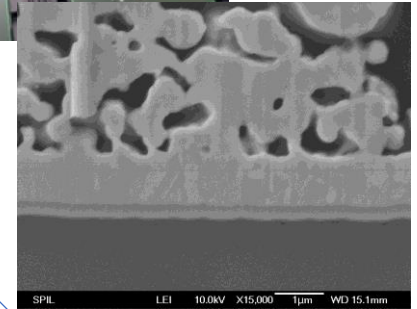
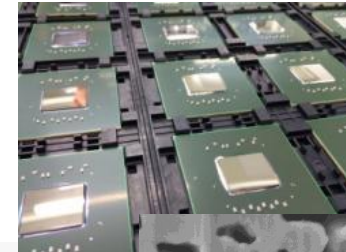
## SIP EMI

SUS/Cu/SUS



## Thermal Dissipation

Ti/NiV/Ag, Ti/NiV/Au



## Plasma Etcher

- Ti/Cu Seed Layer Dry Etch
- Plasma Descum
- Plasma Pre-treatment

## Seeding Sputter

Ti/Cu

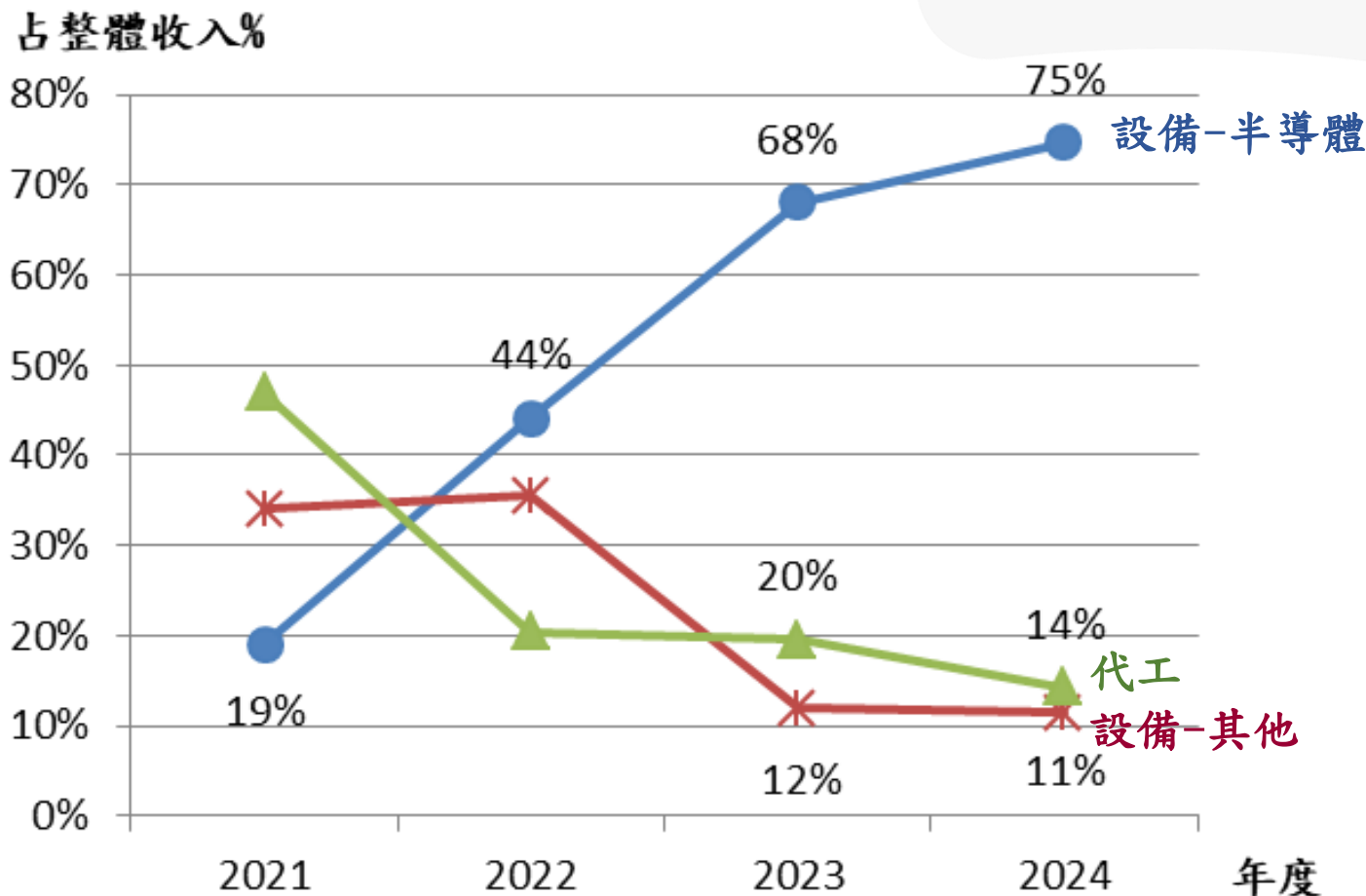




03

經營實績

# 2021~2024Q3 產品占比趨勢



★ 2024年設備營收占比已達86%，其中半導體設備已達75%

★ 代工占比已降至14%

# 2021~2024Q3簡明損益表

單位：NTD仟元

年度	2021	%	2022	%	2023	%	2024Q3	%
營業收入	773,161	100%	1,038,477	100%	744,579	100%	506,685	100%
營業成本	485,494	63%	561,008	54%	433,846	58%	282,934	56%
營業毛利	287,667	37%	477,469	46%	310,733	42%	223,751	44%
營業費用	151,613	20%	200,726	19%	187,679	25%	144,911	28%
營業淨利	136,054	18%	276,743	27%	123,054	17%	78,840	16%
稅前淨利	141,451	18%	328,355	32%	133,343	18%	101,557	20%
稅後淨利	116,120	15%	247,299	24%	102,216	14%	173,060	34%
EPS	3.02		6.37		2.63		4.44	

# 04

## 未來展望

# 玻璃基板 Glass Core及 TGV

## Plasma for RDL

表面改質/孔底清潔

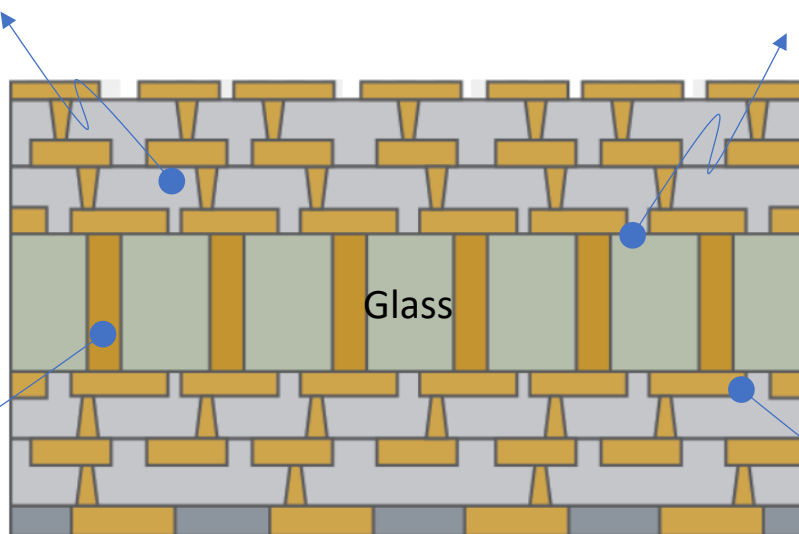
PE-01 Series

PE-02 Series

PE-03 Series

PE-01 Series

電漿表面改質



PE-02 Series

種子層鍍膜\_Ti/Cu



玻璃鑽孔  
(Glass Via Drilling)



# 重大資本支出

- 地點：台中市大雅區(鄰近中科)
- 面積：近3700坪
- 預計正式投產時間：2026年第三季
- 預計產能：現有產能5倍以上
- 綠建築/智慧建築
- 擴大半導體研發中心



# 免責聲明

- ◆ 本簡報及同時發布之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- ◆ 本公司未來實際產生之營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測市場及資訊有差異，其原因為競爭、國際經濟狀況、匯率波動、以及需求其他價格波動等各種因素，包括但不限於此。
- ◆ 本簡報中所提供之資訊，係反映本公司截至目前為止對未來之看法，並未明示或暗示其準確性、完整性或可靠性。對新或修正之資訊，本公司將另行公告。
- ◆ 未經本公司允許情況下，不可複製、修改、重新編譯、刪減或傳送本簡報任何內容，或將任何該等內容作為商業用途。

# UVAT

Vacuum Ecosystems

**Thank you**

友威科技股份有限公司  
UVAT Technology Co., Ltd.

